



深圳市芯瑞自动化科技有限公司
Shenzhen Xinrui Automation Technology Co., Ltd
芯瑞焱（上海）科技有限公司
Xinruiyan (Shanghai) Technology Co., Ltd

深圳总部: 广东省深圳市宝安区松岗满京华科创工坊3栋13F
上海公司: 上海市闵行区浦江镇恒西路139号809室爱登堡科技园
电话: 152 21737757 屠经理
邮箱: tuxi@edenmotion.com.com
网址: www.edenmotion.com 和 www.xrui-tech.com

The Passion For Automation

等离子技术
Plasma Technology

机器视觉
Machine Vision

自动化解决方案
Automation Solution



产品展示册

PRODUCT DISPLAY BOOKLET



公司简介 COMPANY PROFILE

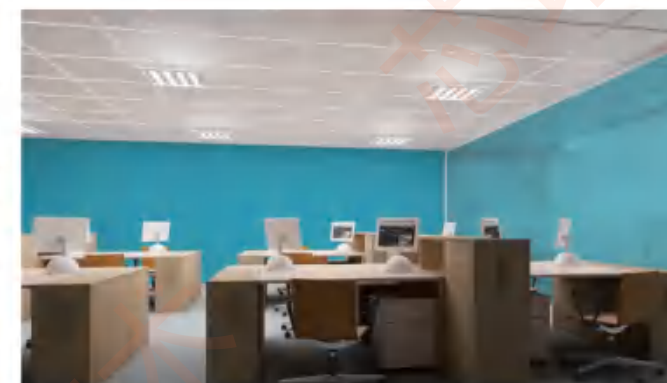
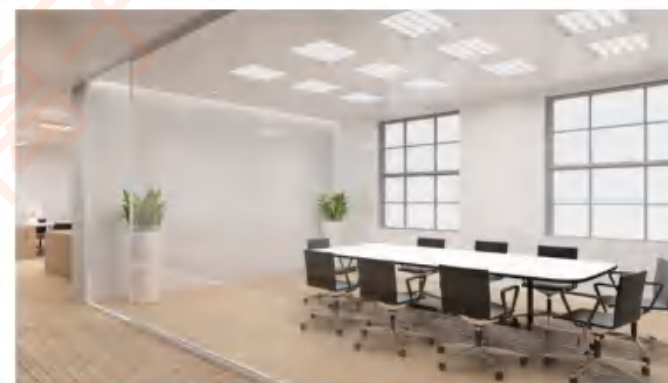
- 深圳市芯瑞自动化科技有限公司主要从事等离子表面处理设备及机器视觉检测相关设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的高新技术企业。
深圳市芯瑞自动化科技有限公司于2021年10月与等离子核心技术领导品牌深圳市诚峰智造有限公司（CRF）联合成立。
- 芯瑞自动化以深圳总部为研发，测试，销售及技术服务为核心，先后于2022年成立了开平生产基地，同年成立了华东及西南分公司，更加贴近客户，服务客户。
芯瑞自动化汇集十多年电子装配、MINI LED及半导体行业技术研究经验的工程师及开发人员，以先进智造技术为基础，不断研发等离子处理相关设备及半导体3D自动光学检测设备。

SHENZHEN XINRUI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. IS MAINLY ENGAGED IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION, SALES, AND VALUE-ADDED SERVICES OF PLASMA SURFACE TREATMENT EQUIPMENT AND MACHINE VISION INSPECTION RELATED EQUIPMENT. IT IS A HIGH-TECH ENTERPRISE WITH INDEPENDENT RESEARCH AND INNOVATION CAPABILITIES.

SHENZHEN XINRUI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. WAS JOINTLY ESTABLISHED IN OCTOBER 2021 WITH SHENZHEN SING FUNG INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD. (CRF), A LEADING BRAND IN PLASMA CORE TECHNOLOGY.

XINRUI AUTOMATION FOCUSES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT, TESTING, SALES, AND TECHNICAL SERVICES AT ITS HEADQUARTERS IN SHENZHEN. IT ESTABLISHED A PRODUCTION BASE IN KAIPING IN 2022 AND ESTABLISHED OFFICES IN EAST AND SOUTHWEST CHINA IN THE SAME YEAR, WHICH IS MORE CUSTOMER-ORIENTED AND SERVES CUSTOMERS.

XINRUI AUTOMATION GATHERED ENGINEERS AND DEVELOPERS WITH OVER TEN YEARS OF EXPERIENCE IN ELECTRONIC ASSEMBLY, MINI LED, AND SEMICONDUCTOR INDUSTRY TECHNOLOGY RESEARCH. BASED ON ADVANCED INTELLIGENT MANUFACTURING TECHNOLOGY, WE CONTINUOUSLY DEVELOP PLASMA PROCESSING RELATED EQUIPMENT AND SEMICONDUCTOR 3D AUTOMATIC OPTICAL TESTING EQUIPMENT.



- ◆ 拥有世界级的产品研发中心以及实验室
全套制作流程符合国际标准

- 芯瑞自动化先后推出了3C自动在线式等离子处理设备、汽车配件真空等离子设备、MINI LED基板等离子处理设备、半导体芯片、传感器、光通信模块及功率器件、IGBT在线式真空等离子设备、在线式微波等离子处理设备、半导体封装3D自动光学检测设备（3D-AOI）。满足了3C电子产品、汽车配件及汽车电子、新能源、MINI LED、半导体封装制程工艺等等离子处理需求。芯瑞自动化研发的半导体封装2D/3D光学检测设备，完美解决了半导体封装相关产品DIE BONDING/WIRE BONDING制程全线工艺的质量检测需求。
- 芯瑞自动化产品主要广泛应用于SMT、SMD、航空航天、汽车电子、半导体、智能手机、平板电脑、医疗器件、工业控制及MINI LED等各个行业。客户遍及华南、华东、华北、西南、西北地区；产品出口到中国台湾、欧洲、越南、印度等地。芯瑞自动化以完整的产品线、广泛的客户群、稳定的产品性能，获得了众多客户的好评。
芯瑞自动化的全体员工将以“芯技术引领新发展”为理念，成为等离子应用技术与半导体封装检测技术领先服务商。

XINRUI AUTOMATION SUCCESSFULLY LAUNCHED 3C AUTOMATIC ONLINE PLASMA PROCESSING EQUIPMENT, AUTOMOTIVE PARTS VACUUM PLASMA EQUIPMENT, MINI LED SUBSTRATE PLASMA PROCESSING EQUIPMENT, SEMICONDUCTOR CHIPS, SENSORS, OPTICAL COMMUNICATION MODULES AND POWER DEVICES, IGBT ONLINE VACUUM PLASMA EQUIPMENT, ONLINE MICROWAVE PLASMA PROCESSING EQUIPMENT, AND 3D AUTOMATIC OPTICAL INSPECTION EQUIPMENT (3D-AOI) FOR SEMICONDUCTOR PACKAGING. IT MEETS THE PLASMA TREATMENT NEEDS OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS, AUTOMOTIVE ACCESSORIES, AUTOMOTIVE ELECTRONICS, NEW ENERGY, MINI LED, SEMICONDUCTOR PACKAGING AND OTHER PROCESS PROCESSES. THE 2D/3D OPTICAL TESTING EQUIPMENT FOR SEMICONDUCTOR PACKAGING DEVELOPED BY XINRUI AUTOMATION PERFECTLY MEETS THE QUALITY TESTING REQUIREMENTS OF THE ENTIRE DIE BONDING/WIRE BONDING PROCESS FOR SEMICONDUCTOR PACKAGING RELATED PRODUCTS.

XINRUI AUTOMATION PRODUCTS ARE MAINLY WIDELY USED IN VARIOUS INDUSTRIES SUCH AS SMT, SMD, AEROSPACE, AUTOMOTIVE ELECTRONICS, SEMICONDUCTORS, SMARTPHONES, TABLETS, MEDICAL DEVICES, INDUSTRIAL CONTROL, AND MINI LED. CUSTOMERS ARE LOCATED IN SOUTH CHINA, EAST CHINA, NORTH CHINA, SOUTHWEST, AND NORTHWEST REGIONS; THE PRODUCTS ARE EXPORTED TO TAIWAN, CHINA, EUROPE, VIETNAM, INDIA AND OTHER PLACES. XINRUI AUTOMATION HAS WON PRAISE FROM NUMEROUS CUSTOMERS FOR ITS COMPLETE PRODUCT LINE, EXTENSIVE CUSTOMER BASE, AND STABLE PRODUCT PERFORMANCE.

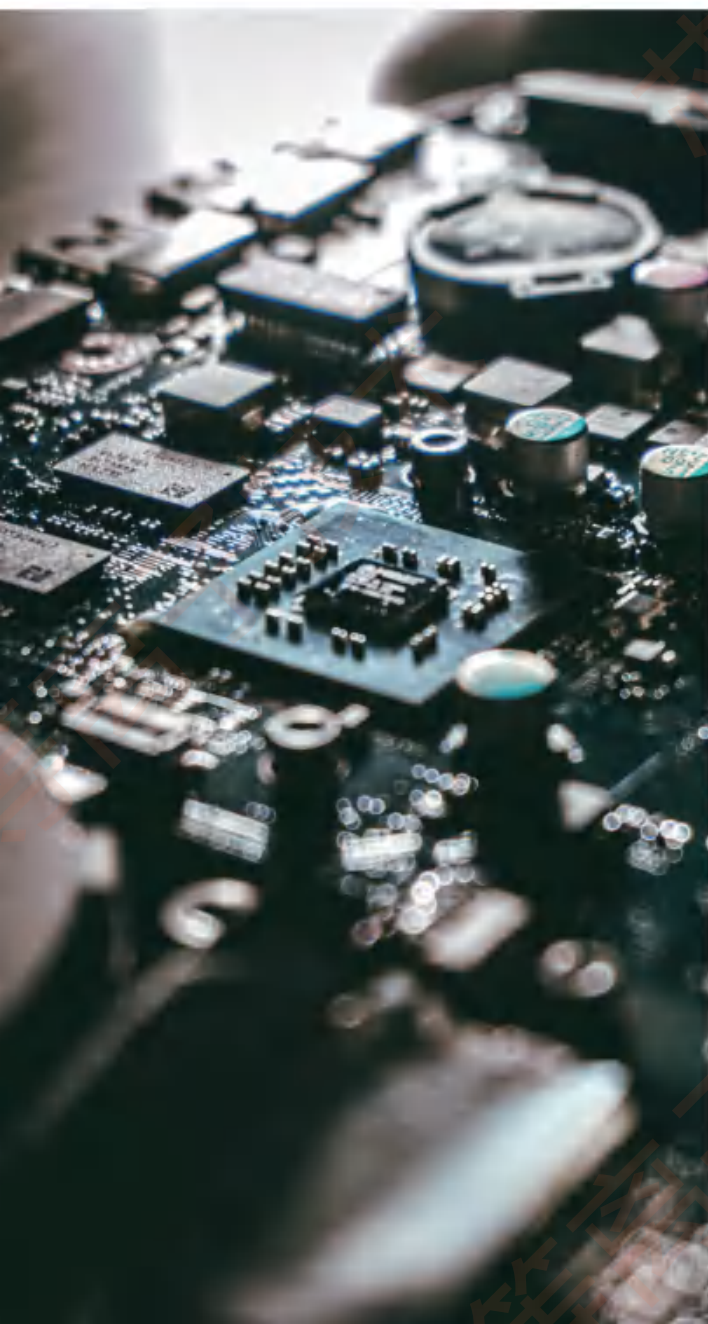
ALL EMPLOYEES OF XINRUI AUTOMATION WILL ADHERE TO THE CONCEPT OF "LEADING NEW DEVELOPMENT WITH CORE TECHNOLOGY" AND BECOME A LEADING SERVICE PROVIDER FOR PLASMA APPLICATION TECHNOLOGY AND SEMICONDUCTOR PACKAGING AND TESTING TECHNOLOGY.



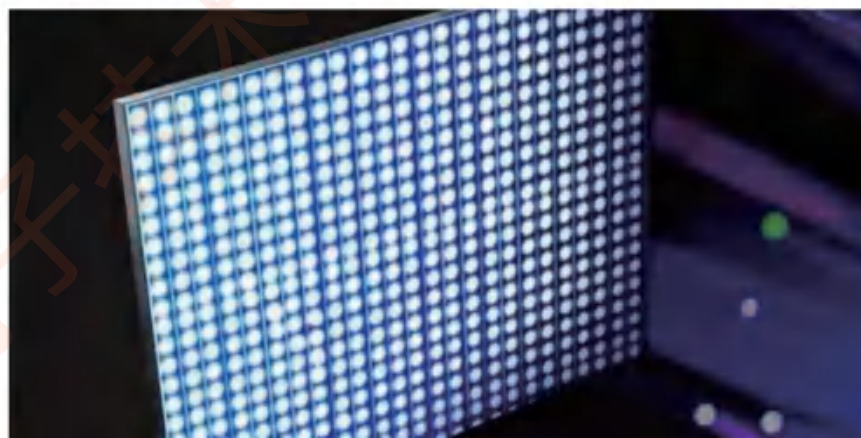
汽车制造
Automotive manufacture



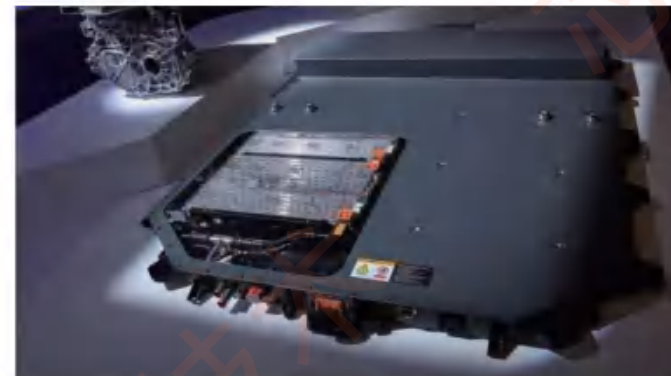
应用领域 APPLICATION AREA



半导体领域
Semiconductor field



新能源电池
New energy batteries



科研医疗
Medical treatment



传感器
sensor



光通信模块
Optical communication module



等离子清洗
Plasma cleaning



荣誉证书 CERTIFICATE OF HONOR



CERTIFICATE OF HONOR

合作客户
COOPERATIVE CLIENTS



huami



CORNING



PEGATRON
和碩聯合科技



Amphenol

产品目录

PRODUCT CATALOG



01 / 旋转磁枪常压等离子处理设备
XR-APO-RD50-HD



03 / 直喷磁枪常压等离子处理设备
XR-APO-RD1010-HN



05 / 真空式等离子处理系统
XR-VPO-MC-6L



19 / 手机自动拆屏设备
XR-ATP-1701



21 / LED柔性灯带等离子处理设备
XR-APO-220WR



23 / 四头辊轮式等离子处理设备
XR-APO-RD1010-HN



07 / 在线式平板电脑TP&中框等离子处理设备
XR-APO-390MP



09 / 在线式手机TP&中框等离子处理设备
XR-APO-1013MF



11 / 在线PCB等离子处理吸码设备
XR-APO-390MP



25 / 四通道在线式真空等离子设备
XR-VCP-204S



27 / CCD视觉辅助贴合设备
XR-VAP-200



13 / 全自动On-Line式AP等离子处理设备
XR-APO-800PS



15 / 四头在线式等离子处理设备
XR-APO-4000W-C



17 / MiniLED在线式等离子处理+USC除尘设备
XR-VCP-1013MF



29 / 汽车配件等离子处理设备
XR-VCP-2120AM

XR-APO-RD50-HD

旋转喷枪常压等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TR MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

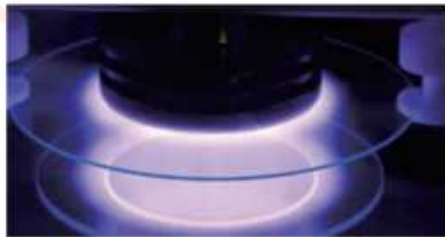
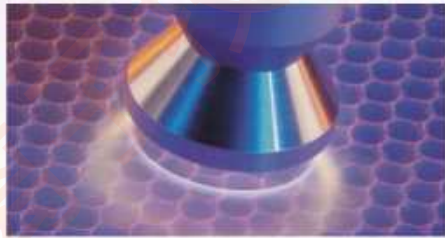


产品特点

- 采用PFC全桥数字式等离子电源发生器，功率输出稳定，抗干扰能力强，响应迅速。
- 可选配多重等离子喷枪和喷嘴，适用于不同场合，满足不同产品处理工艺需求。
- 高度集成软件系统具备气压、电流、电压、频率、功率、脉冲转速等实时监控功能。
- 独特的主板功率补偿机制使 Electrode 消耗变化时，等离子体浓度不受影响，且电源端稳定输出高功率，功率因素达到 0.98 以上。
- 增加Remote Control 接口，提升系统整合的便利性。同时具有 I/O 接口，在简易控制场景时，启停便利。

应用范围

应用于各类汽车制造、手机/智能穿戴、医疗器械、航空器材、军工、半导体封装、MiniLED、PCB/FPC、锂电、太阳能、TP组件等产品或材料表面等离子处理。



基本参数

设备型号	XR-APO-RD50-HD
等离子功率	300-1000W可调
激发频率	25Khz-30Khz可调
功率因素	0.99
处理高度	5-15mm
内部控制模式	PFC全桥数字式
外部控制模式	启停I/O、RS485/RS232、模拟通讯口
喷枪类型	旋喷式
处理范围	20-50mm喷嘴可选
重量	10kg+5kg主机+喷枪
气压范围	0.10~0.4Mpa
气体种类	压缩空气/氮气
监控功能	电流监控
	电压监控
	频率监控
	功率监控
	脉冲转速监控
	气体压力监控
	等离子断火监控（选配）
	气体流量监控（选配）



正视图



右视图



侧视图



背视图

XR-APO-RD1010-HN

直喷喷枪常压等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TR MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

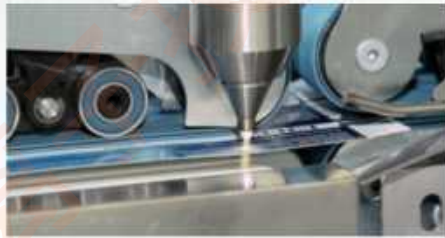


产品特点

- 采用PFC全桥数字式等离子电源发生器，功率输出稳定，抗干扰能力强，响应迅速。
- 可选配多重等离子喷枪和喷嘴，适用于不同场合，满足不同产品处理工艺需求。
- 高度集成软件系统具备气压、电流、电压、频率、功率、脉冲转速等实时监控功能。
- 独特的主板功率补偿机制使 Electrode 消耗变化时，等离子体浓度不受影响，且电源端稳定输出高功率，功率因素达到 0.98 以上。
- 增加Remote Control 接口，提升系统整合的便利性。同时具有 I/O 接口，在简易控制场景时，启停便利。

应用范围

应用于各类汽车制造、手机/智能穿戴、医疗器械、航空器材、军工、半导体封装、MiniLED、PCB/FPC、锂电、太阳能、TP组件等产品或材料表面等离子处理。



基本参数

设备型号	XR-APO-RD1010-HN
等离子功率	300-800W可调
激发频率	30Khz
功率因素	0.99
处理高度	5-15mm
内部控制模式	PFC全桥数字式
外部控制模式	启停I/O、RS485/RS232、模拟通讯口
喷枪类型	直喷式
处理范围	2-6mm喷嘴可选
重量	10kg+4kg主机+喷枪
气压范围	0.10-0.4Mpa
气体种类	压缩空气/氮气
监控功能	电流监控
	电压监控
	频率监控
	功率监控
	气体压力监控
	等离子断火监控（选配）
	气体流量监控（选配）



正视图



右视图



侧视图

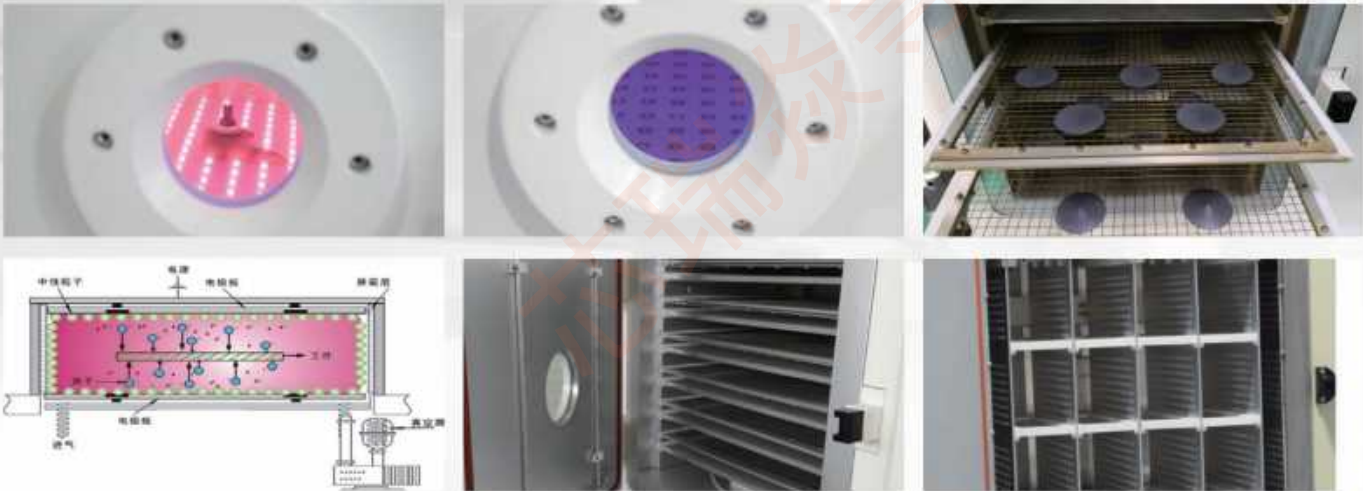


背视图

XR-VPO-MC-6L

真空式等离子处理系统

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TR MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 超大处理空间，提升处理产能，采用PLC+触摸屏控制系统，精确的控制设备运行；
- 可按客户要求定制设备腔体容量和层数，满足客户的需求；
- 保养维修成本低，便于客户成本控制；
- 高精度，快响应，良好的操控性和兼容性，完善的功能和专业的技术支持；
- 可处理材料种类广泛；
- 对于精密器件及外观不规则产品可以实现浸泡式处理；
- 均匀性达90%以上。

应用范围

适用于印制线路板行业，半导体IC领域，硅胶、塑胶、聚合物领域，汽车电子行业，航空工业等。印制线路板行业：高频板表面活化，多层板表面清洁、去油污，软板、软硬结合板表面清洁、去油污，软板补强前活化。半导体IC领域：COB、COG、COF、ACF工艺，用于打线，焊接前的清洗；硅胶、塑胶、聚合物领域：硅胶、塑胶、聚合体的表面粗化、刻蚀、活化。



名称	真空式等离子处理系统		
型号	XR-VPO-8L-M	XR-VPO-8L-S	XR-VPO-MC-6L
控制系统	PLC+触摸屏	PLC+触摸屏	PLC+触摸屏
电源	380V/AC,50/60Hz,3kw	380V/AC,50/60Hz,3kw	380V/AC,50/60Hz,12.5kw
射频电源功率	600W/13.56MHz	600W/13.56MHz	2000W/40kHz
容量	80L(Option)	80L(Option)	235L(Option)
层数	8(Option)	8(Option)	6(Option)
有效处理面积	400(L)*300(W)(Option)	400(L)*300(W)(Option)	500(L)*500(W)(Option)
气体通道	两路工作气体可选 Ar、N2、H2、CF4、O2	两路工作气体可选 Ar、N2、H2、CF4、O2	两路工作气体可选 Ar、N2、H2、CF4、O2
外形	镜面不锈钢	钣金结构	钣金结构

XR-APO-390MP

在线式平板电脑TP&中框等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 等离子路径原件自动保护机构，路径规划避让
- 在线式全自动轨道调宽+高速等离子清洗+读码检测（可选）
- 内置制氮模块，氮气保护等离子工艺处理，稳定可靠防止材料表面氧化
- 具备MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率多功能集合，等离子处理提升材料表面张力，提升良率

应用范围

应用于各种类型手机、平板等3C电子产品的TP、中框、盖板、摄像头模组及金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理；提升粘接、涂覆、印刷、镀膜等工艺良率。



基本参数

设备型号	XR-APO-390MP
控制系统	PLC+上位机
适用工件	PA或玻璃表面/金属合金表面
XYZ轴定位精度	XY:±20um Z:±10um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±5um
定位系统	传感器定位
最大速度	1000mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
轨道调宽范围	50-260mm
处理最大范围	390*260 (W*D)
设备产能	≥300pcs
通讯系统接入	MES
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 3kw
外型尺寸	W1000*D1200*H1700
重量	500kg

附件可选项

FFU空气净化系统	集成臭氧净化器，有效处理有害气体
内置制氮机	防止清洁面氧化，气体流量需要可调
数据可视化	温度、功率、频率、电流、气压等
吸尘	内部集成吸尘装置
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、模拟通信接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，二维码读码并上传MES

等离子系统

功率	600-1000W/25KHz（可选）
等离子气体	CDA (0.4Mpa) /N ₂ (0.2Mpa)
处理范围	直喷式：2-10mm（可选）
处理高度	5-15 mm
处理速度	50-300 mm/s

XR-APO-1013MF

在线式手机TP&中框等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

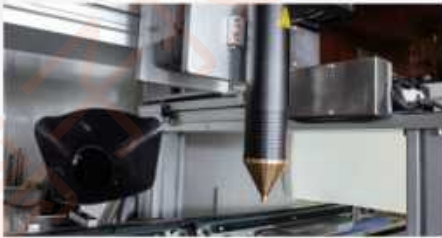


产品特点

- 等离子路径原件自动保护机构，路径规划避让
- 在线式全自动轨道调宽+高速等离子清洗+读码检测（可选）
- 内置FFU空气净化模块，保证处理环境清洁，减少粉尘颗粒物
- 具备MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率多功能集合，等离子处理提升材料表面张力，提升良率

应用范围

应用于各种类型手机、平板等3C电子产品的TP、中框、盖板、摄像头模组及金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理；提升粘接、涂覆、印刷、覆膜等工艺良率。



基本参数

设备型号	XR-APO-1013MF
控制系统	PLC+上位机
适用工件	PA或玻璃表面/金属合金表面
XYZ轴定位精度	XY:±20um Z:±10um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±5um
定位系统	传感器定位
最大速度	1000mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
轨道调宽范围	50-260mm
处理最大范围	300*200 (W*D)
设备产能	≥400pcs
通讯系统接入	MES
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 3kw
外型尺寸	W1100*D900*H1700
重量	500kg

附件可选项

FFU空气净化系统	集成臭氧净化器，有效处理有害气体
数据可视化	温度、功率、频率、电流、气压等
吸尘	内部集成吸尘装置
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、模拟通信接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，二维码读码并上传MES

等离子系统

功率	600-1000W/25KHz（可选）
等离子气体	CDA（0.4Mpa）/N ₂ （0.2Mpa）
处理范围	直喷式：2-5mm（可选）
处理高度	5-15 mm
处理速度	50-300 mm/s

XR-APO-510P

在线式PCB等离子处理喷码设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

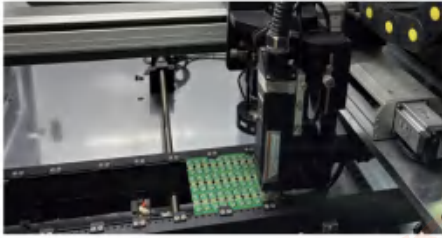
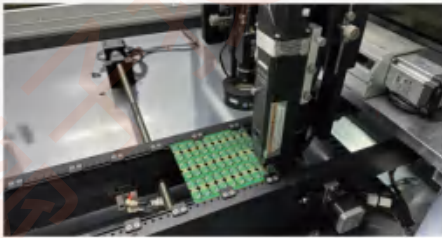


产品特点

- 在线式全自动高速等离子清洗+喷码（可选）+读码检测（可选）设备
- 高性价比：一体式机架设计，机构稳定；上位机软件控制，自动完成Mark点识别定位、等离子处理，喷码，读码流程，效率更高；使用国际顶级元器件，减小故障发生率，大大降低使用成本，减少易损部件，节约购置成本
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率，多功能集合，等离子处理提升喷码效果及后段锡膏印刷质量，提升良率

应用范围

应用于各种类型PCB、FPC、Mini LED基板、金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理及喷印；可旋转多角度进行喷印；墨水即喷即干，喷印的内容在这回流焊前可用酒精擦拭，过炉高温固化后，油墨可以抗酒精、抗摩擦和IPA腐蚀等。



基本参数

设备型号	XR-APO-510P
控制系统	PLC+上位机
适用工件	PCB
XYZ轴定位精度	XY:±20um Z:±10um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±5um
定位系统	CCD+MARK定位 ±5um
最大速度	1000mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机
轨道调宽范围	50-510mm
处理最大范围	510*610 (W*D)
基板厚度	0.5-5mm
通讯系统接入	MES、IMS、SH
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 3kw
外型尺寸	W1200*D1400*H1600
重量	800kg

附件可选项

品牌	可选配KEYENCE/DOMINO/KGK
喷印精度	115dip
解析度	40um/60um喷嘴
字符高度	可喷0.6mm字符，数字；
二维码大小	可喷3mm*3mm QR码

等离子系统

功率	600-1000W/25KHz（可选）
等离子气体	CDA（0.4Mpa）/N ₂ （0.2Mpa）
处理范围	旋喷式：20-80mm（可选）
处理高度	5-15 mm
处理速度	50-300 mm/s

XR-APO-800PS

全自动On-Line式宽幅AP等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 自动Z轴调高
- 高性能宽幅等离子喷头，高速线性等离子体
- 氮气保护模块
- 自动抽风系统，工作现场无烟雾残留、无清洗产生的异味
- 等离子发生系统、流量控制系统、冷却系统自动控制启停

应用范围

应用于各种类型PCB、FPC、Mini LED基板、玻璃盖板、陶瓷材料、金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理



基本参数

设备型号	XR-APO-800PS
控制系统	PLC
适用工件	PCB、FPC、玻璃盖板、陶瓷基板等
XYZ轴定位精度	XY:±0.3mm Z:±0.2mm
XYZ轴重复精度	XYZ:±0.2mm
最大速度	3000mm/s(流水带)
驱动系统	步进电机
轨道调宽范围	800 mm
处理最大范围	1800*920 (W*D)
材料厚度	0.5-5mm
冷却方式	冰水冷却装置
主机气源	0.5-0.7MPa, 可选AR+O ₂ 两路气体
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 3kw
外型尺寸	W1950*D1250*H1420
重量	300kg

等离子系统

功率	300-600W/25KHz (可选)
等离子气体	CDA (0.4Mpa) /N ₂ (0.2Mpa)
处理范围	800mm宽幅喷头
处理高度	1-5 mm
处理速度	50-300 mm/s



XR-APO-4000W-C

四头在线式等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

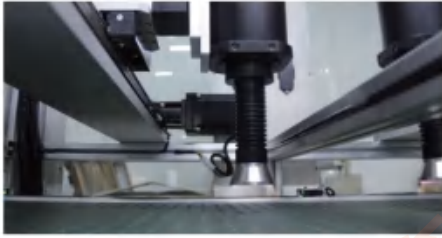
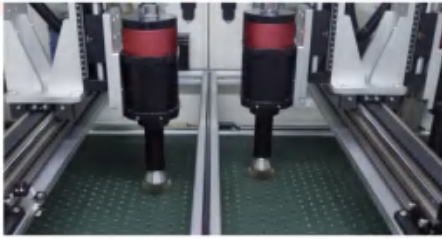


产品特点

- 模块化Z轴调高
- 高速直驱等离子喷头，高密度等离子体
- FFU空气净化系统，保证处理环境洁净度
- 自动抽风系统，工作现场无烟雾残留、无清洗产生的异味
- 等离子发生系统、流量控制系统、冷却系统自动控制启停

应用范围

应用于各种类型PCB、FPC、Mini LED基板、玻璃盖板、陶瓷材料、金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理

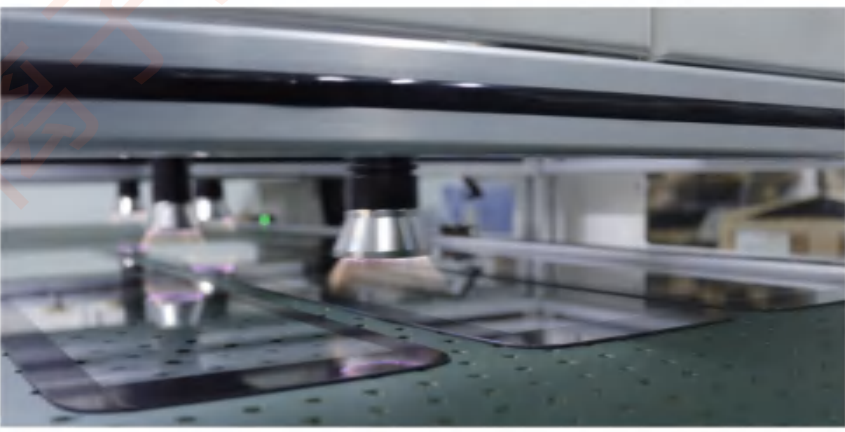


基本参数

设备型号	XR-APO-4000W-C
控制系统	PLC
适用工件	PCB、FPC、玻璃盖板、陶瓷基板等
XYZ轴定位精度	XY:±0.3mm Z:±0.2mm
XYZ轴重复精度	XYZ:±0.2mm
最大速度	500mm/s(流水带)
驱动系统	步进电机
轨道宽度范围	700 mm
处理最大范围	2000*700 (W*D)
材料厚度	0.5-5mm
冷却方式	风冷却装置
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 4.8kw
外型尺寸	W2200*D1200*H1950
重量	280kg

等离子系统

功率	300-100W/25KHz*4组(可调)
等离子气体	CDA (0.4Mpa) /N ₂ (0.2Mpa)
处理范围	10-50mm 旋转喷头(可选配)
处理高度	5-10 mm
处理速度	10-300 mm/s



XR-VCP-1013MF

MiniLED在线式等离子处理+USC除尘设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



USC除尘
USC DUST REMOVAL



等离子清洗
PLASMA CLEANING



在线式运送
ONLINE TRANSPORTATION



智能化操控
INTELLIGENT CONTROL

USC除尘系统

传送方式	模组 固定/吸附物料移栽
处理高度	1.5--5 mm
清洗线速度	40--80 mm/s
除尘效率	98.2%--99.7% 测试颗粒=5μm
清洗压强	20--25 Kpa

产品特点

- 在线式全自动轨道调宽+高速等离子清洗+USC干式超声除尘
- 内置FFU空气净化模块，保证处理环境清洁，减少粉尘颗粒物
- 可选MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率多功能集合，等离子处理提升材料表面张力，提升良率

应用范围

应用于MiniLED不同的材料基板及MiniLED RGB直显面板等表面等离子处理；提升基板锡膏印刷、Die bonding、Wire bonding性能及后道填缝点胶、涂覆填充、印刷、覆膜、塑封等工艺良率。



基本参数

设备型号	XR-VCP-1013MF
控制系统	PLC+上位机
适用工件	MiniLED PCB基板、陶瓷基板、玻璃基板
XYZ轴定位精度	XY:±10um Z:±10um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±5um
定位系统	传感器定位
最大输送速度	500mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
轨道调宽范围	50-260mm
处理最大范围	320*460mm (W*D)
设备产能	≥400pcs
通讯系统接入	MES 选配
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 5kw
外型尺寸	W1450*D1100*H1650
重量	600kg

附件可选项

FFU空气净化系统	集成臭氧化器，有效处理有害气体
数据可视化	温度、功率、频率、电流、气压等
USC除尘系统	超声波震荡+真空，高效去除材料表面微颗粒
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、模拟通信接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，二维码读码并上传MES

等离子系统

功率	600-1000W/13.56MHz射频电源（可选）
等离子气体	2路工艺气体（可选）：氩气，氢气，氧气，氮气，CF ₄
真空腔体尺寸	490*350*50mm (L*W*H)（可定制）
真空探测	皮拉尼式真空规
真空泵	双级旋叶泵+罗茨泵
处理速度	30-45 s/pcs

XR-ATP-1701

手机自动拆屏设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 拆解治具可更换通用型自动拆屏设备
- 设备拆解过程三段式参数可调，依据不同工艺要求设置各段拆解参数，提升拆解良率
- 拆解屏幕过程实时真空监控，具备回弹缓冲功能
- 组件预热时间自动监控，防止预热不充分导致拆解不良
- 超高拆解良率，TP模组及中框组件拆解不良率低于5

应用范围

应用于各类手机及平板电脑的上盖组件TP模组与中框自动预热、自动分离拆解。



基本参数

设备型号	XR-ATP-1701
控制系统	PLC
适用工件	手机上盖组件、平板电脑
XYZ轴定位精度	XY:±10um Z:±10um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±5um
定位系统	传感器定位
最大拆解速度	100mm/s(X)
驱动系统	伺服电机/步进电机
拆屏治具定位精度	0.02-0.05 mm
拆解良率	大于99%
设备产能	25-60 s/pcs
预热控温	±1℃
兼容拆机尺寸	220*200mm (L*W)
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 2kw
外型尺寸	W1000*D750*H1400
重量	200kg

附件可选项

手机预热板自动监控系统	预热区时间管控及误操作提醒
-------------	---------------

XR-APO-220WR

LED柔性灯带等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 模块化Z轴调高
- 高速直驱等离子喷头，高密度等离子体
- 定制型防静电粘尘机构，高效去除灯带表面微尘颗粒物
- 卷对卷送料实时等离子处理，待料自动停机等待
- 自动抽风系统，工作现场无烟雾残留、无清洗产生的异味
- 等离子喷枪温度、功率、转速、电压、电流等参数实时监控

应用范围

应用于各种类型COB LED灯带、Mini LED灯带点银浆固晶或锡膏印刷前表面等离子活化及除尘清洁，提升点银浆及锡膏印刷工艺良率，改善灯带固晶及后道焊接品质。



基本参数	
设备型号	XR-APO-220WR
控制系统	PLC
适用工件	柔性COB LED灯带
XYZ轴定位精度	XY:±0.3mm Z:±0.2mm
XYZ轴重复精度	XYZ:±0.2mm
最大速度	500mm/s(输送带)
驱动系统	步进电机
轨道调宽范围	200 mm
处理最大范围	50-200 (W*D)
材料厚度	0.5-3mm
冷却方式	抽风冷却装置
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC, 50/60Hz, 1.5kw
外型尺寸	W800*D700*H1500
重量	150kg

粘尘机构	
粘尘辊轮	防静电硅胶粘尘滚轮*2
粘尘纸	防静电粘尘纸*1 可替换
静电消除系统	KESD 宽幅

等离子系统	
功率	300-100W/25KHz*1组 (可调)
等离子气体	CDA (0.4Mpa) /N ₂ (0.2Mpa)
处理范围	20-50mm 旋转喷头 (可选配)
处理高度	5-10 mm
处理速度	20-250 mm/s

XR-APO-650W-R

四头辊轮式等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.



产品特点

- 模块化Z轴调高
- 高速直驱等离子喷头，高密度等离子体
- FFU空气净化系统，保证处理环境洁净度
- 等离子喷枪温度、功率、转速、电压、电流等参数实时监控
- 等离子发生系统、流量控制系统、冷却系统自动控制启停

应用范围

应用于各种类型PCB、FPC、Mini LED基板、玻璃盖板、陶瓷材料、金属屏蔽罩等不同的材料表面等离子处理



基本参数

设备型号	XR-APO-650W-R
控制系统	PLC
适用工件	PCB、FPC、玻璃盖板、陶瓷基板等
XYZ轴定位精度	XY:±0.3mm Z:±0.2mm
XYZ轴重复精度	XYZ:±0.2mm
最大速度	500mm/s(辊轮输送)
驱动系统	步进电机
轨道宽度范围	600 mm
处理最大范围	650*500 (W*D)
材料厚度	0.5-5mm
冷却方式	风冷却装置
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 4.5kw
外型尺寸	W1800*D1250*H1800
重量	300kg

等离子系统

功率	300-100W/25KHz*4组 (可调)
等离子气体	CDA (0.4Mpa) /N ₂ (0.2Mpa)
处理范围	10-50mm 旋转喷头 (可选配)
处理高度	5-10 mm
处理速度	10-300 mm/s



XR-VCP-204S

四通道在线式真空等离子设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

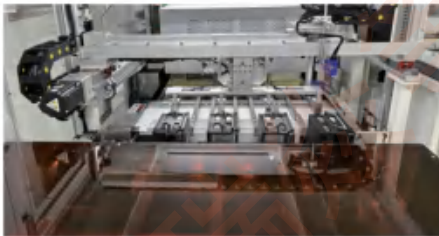
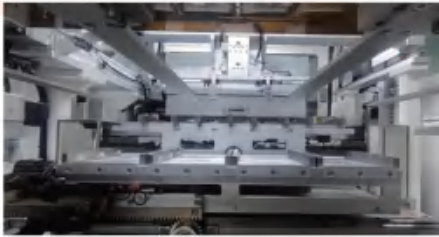


产品特点

- 在线式全自动轨道调宽+高速等离子清洗
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率，多功能集合，可选配多通道多层处理
- 内置FFU空气净化模块，保证处理环境清洁，减少粉尘颗粒物
- 可选MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传

应用范围

半导体相关器件如：IC芯片、功率器件、传感器、光通讯模块、IGBT等器件 Die bonding、Wire bonding、塑封、点胶、涂覆填充、印刷、覆膜、等工艺前等离子处理。



基本参数

设备型号	XR-VCP-204S
控制系统	上位机+运动控制器
适用工件	IC芯片、载板、引线框架、传感器、光通信模块、IGBT
XYZ轴定位精度	XY:±20um Z:±20um
XYZ轴重复精度	XY:±10um Z:±10um
定位系统	传感器定位
最大输送速度	500mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
轨道数量	四通道（可选双层四通道）
处理最大范围	320*120mm (L*W)
设备产能	≥300pcs
通讯系统接入	MES或SECS/GEM (选配)
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 6.5kw
外型尺寸	W1900*D1150*H1700
重量	600kg

附件可选项

FFU空气净化系统	集成臭氧净化器，有效处理有害气体
数据可视化	温度、功率、频率、电流、气压等
料盒自动装载系统	料盒装载模块自动进出，可与AGV等自动物料系统搭配通讯
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、模拟通信接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，可多级扫码，二维码读码并上传MES

等离子系统

功率	600-1000W/13.56MHz射频电源（可选）
等离子气体	2路工艺气体（可选）：氩气，氢气，氧气，氮气，CF ₄
真空腔体尺寸	340*740*65mm (W*D*H)（可定制）
真空探测	皮拉尼式真空规
真空泵	双级旋叶泵+罗茨泵
处理速度	35-60 s/4pcs

XR-VAP-200

CCD视觉辅料贴合设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD OF PROCESSES SUCH AS BONDING, COATING, PRINTING, AND LAMINATION.

- 高精度
- 高产能
- 贴装自动化

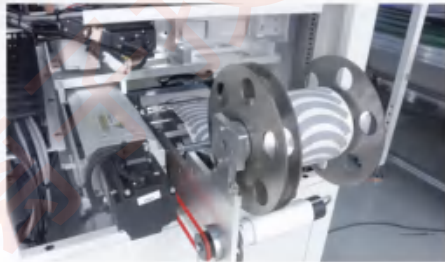


产品特点

- 在线式全自动视觉产品定位，产品方向无限制
- 可选双吸嘴取料、双飞达送料,同时贴合不同物料
- 流水线传送，无需治具工装，通用性高
- 标签辅料飞达剥离，CCD视觉二次对位，高精度贴合
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率，多功能集合
- 可选MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传

应用范围

标签辅料、脚垫及薄膜等贴合如：手机、平板电脑、笔电、玩具、智能终端、医疗器械、安防产品、工业配件、TP、PCB等。

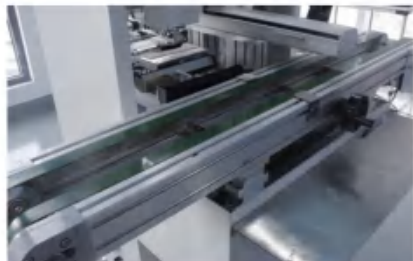


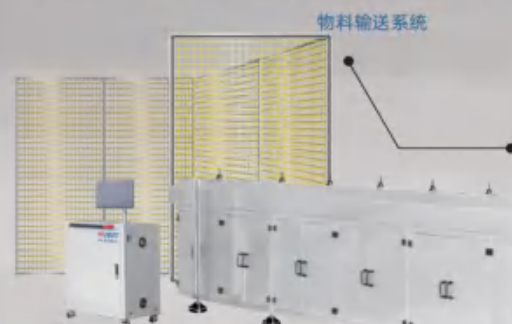
基本参数

设备型号	XR-VAP-200
控制系统	工控机+运动控制器+CCD视觉
适用工件	标签、胶垫、铜片、薄膜、脚垫、标识
XYZ轴定位精度	XY:±0.05mm Z:±0.1mm
贴合精度	±0.1mm
贴装合格率	≥99.5%
定位系统	双CCD视觉+传感器对位
相机硬件	500W像素 双相机（可选1000W像素）
流水线最大输送速度	500 mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
稼动率	≥95%
标签尺寸	≤120*60mm（标准配置）
产品尺寸	≤200*200mm（标准配置）
设备产能	≥1200pcs（单头）
通讯系统接入	MES 选配
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 2kw
外型尺寸	W760*D800*H1800
重量	500kg

附件可选项

飞达组件	可定制后撤式飞达及双物料飞达
流水线组件	可选平皮带流水线，中空调宽流水线，带治具流水线等
吸嘴组件	定制吸嘴，单吸嘴、双吸嘴可选
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、SME接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，可多级扫码，二维码读码并上传MES





XR-VCP-2120AM

汽车配件等离子处理设备

PLASMA TREATMENT OF DIFFERENT MATERIALS SUCH AS TP, MIDDLE FRAME, COVER PLATE, CAMERA MODULE, AND METAL SHIELDING COVER APPLIED TO VARIOUS TYPES OF 3C ELECTRONIC PRODUCTS SUCH AS MOBILE PHONES AND TABLETS; IMPROVE THE YIELD

自动化/等离子集成

基本参数

设备型号	XR-VCP-2120AM
控制系统	PLC+上位机+工业视觉
适用工件	汽车门把手、前挡配件
XYZ轴定位精度	XY:±50um Z:±50um
XYZ轴重复精度	XY:±20um Z:±20um
定位系统	CCD视觉引导+传感器定位
最大输送速度	300mm/s(XY)
驱动系统	伺服电机/步进电机
机械手搬运范围	R1440 mm
处理最大范围	2000*490*450mm (L*W*H)
设备产能	≥400pcs
通讯系统接入	MES (选配)
主机气源	0.5-0.7MPa
主机电源	220V/AC,50/60Hz, 13kw
外型尺寸	W14000*D1800*H2500
重量	2500kg

附件可选项

数据可视化	温度、功率、频率、电流、气压等
远程通信方式	支持TCP/IP、485接口、232接口、模拟通信接口
MES对接	标准MES接口通讯，数据可追踪
扫码功能模块	选配扫码器，二维码读码并上传MES

动态物料搬运系统

传送方式	高精度链条载具+六轴机械手+三轴机械手
流转速度	150mm/s
CCD定位抓取精度	0.1mm
动态追踪抓取良率	大于99.5%

等离子系统

功率	10KW/40KHz中频电源 (可选)
等离子气体	3路0-1000sccm,工作气体可选: Ar、O ₂ 、N ₂ 、H ₂ 等
真空腔体尺寸	2050*500*480mm (L*W*H) (可定制)
真空探测	皮拉尼式真空规
真空泵	双级旋叶泵+罗茨泵
处理速度	5-6 s/pes

产品特点

- 全自动CCD视觉引导机械手动态抓取物料+高速等离子清洗+载具兼容
- 实时监控喷涂线体运行速度，自动匹配等离子处理线体生产节拍
- 具备MES通讯及设备远程通讯协议，将设备运行重要参数实时上传
- 提高生产力：减少人工干预，提高设备稼动率多功能集合，等离子处理提升材料表面张力，提升良率

应用范围

汽车门把手、前挡支架等汽车及汽车电子相关零配件等离子表面处理，提升产品涂覆、点胶、覆膜、印刷等工艺性能。

